

台灣半導體研究中心 異質整合製程組

SE-C14 鍍金機

標準作業程序：

1. MES 控制系統開啟設備
2. POWER：鍍金機電源開關，使用前開啟即可；使用完畢請關閉電源。
3. DISCHARGE CURRENT & VACCUM：真空計和電流計。
4. TIME SETTING：時間設定，單位為秒。REMAIN 顯示設定的反應時間。
5. VOLTAGE & DISCHARGE
6. VOLTAGE 分為 HIGH 為鍍膜模式，LOW 為電漿清潔模式：
7. 電漿清潔：DISCHARGE CURRNET 約為~2 mA，VACCUM 約為 15~20 Pa。
8. 濺鍍模式：DISCHARGE CURRNET 約為 15~18 mA，VACCUM 約為~8 Pa。鍍率約 10 nm/min。
9. 設定好 TIME 及 VOLTAGE MODE 後，按下 DISCHARGE 按鍵即可開始。
10. MAIN VALVE：OPEN 為開啟氣體閥件，抽真空或破除真空皆需要開啟此閥件；CLOSE 關閉氣體閥件用。
11. VACUUM ADJUST：調節反應腔體內部壓力用。當設定好 TIME 及 VOLTAGE MODE，按下 DISCHARGE 後，藉由此旋鈕調整內部壓力，使內部達到符合所執行模式的 VACCUM 及 DISCHARGE CURRENT 環境。
12. 製程結束，請將腔體抽真空。
13. MES 控制系統 關閉設備。